Lotpaste NO-CLEAN TLF-204-171A, bleifrei, für Druckprozesse, 1 Kartusche = 600 g

Die bleifreie Lotpaste TLF-204-171AK ist entwickelt worden, um speziell die Anforderungen von anspruchsvollen Druckvorgängen zu erfüllen. Die Paste bietet exzellente Druckigenschaftem, sowohl cold slump als auch hot slump und damit auch die Bildung von unerwünschten Brücken werden vermieden. Durch die verbesserte Aktivierung des Flussmittels wird bei TLF-204-171AK eine Minimierung von Head-in-Pillow-Fehlern erreicht. Gleichzeitig führt die gute Aktivierung zu einer guten Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen. Benetzungs- und Lotperlentest sowie die Konturenstabilität entsprechen höchsten Anforderungen. TLF-204-171AK ist eine NO-CLEAN Paste - die Rückstände können auf den Lötstellen verbleiben, ohne das diese zu Problemen mit Korrosion oder Elektromigration führen.

- Lotpaste NO-CLEAN, bleifrei
- für Druckprozesse
- Klassifizierung ROL0
- Metallgehalt 88,5 %
- Legierung Sn96,5Ag3Cu0,5
- Korngröße 4 (20-38 µm)
- 1 Kartusche = 600 g
- Reduzierung von Head-in-Pillow-Fehlern
- Hohe Aktivität auf allen Substraten
- gute Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen
- Exzellente Druckeigenschaften
- Gute Klebrigkeit von bis zu 24h
- Flussmittelklassifizierung J-STD-004: ROL0

Artikel-Nr.	**WL45185**
Modell	Pastentyp TLF-204-171AK
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	LOTPAST8004
GPSR Herstellerdaten	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkaufseinheit	1 Kartusche
Inhaltseinheit	600 g
Flussmittelklasse	ROL0
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei